MENU SEARCH SINDEX DETAIL BACK NEXT

3 / 5

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-219221

(43)Date of publication of application: 18.08.1995

(51)Int.CI.

G03F 7/027 G03F 7/027 G03F 7/027 G03F 7/004 G03F 7/033 H01L 21/027

(21)Application number: 06-014298

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

08.02.1994

(72)Inventor: FURUBAYASHI HIROMI

KAWAGUCHI TAKU KIMURA JINKO

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND PHOTOSENSITIVE FILM USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photosensitive resin compsn. excellent in adhesion to the base metal and chemical resistance by incorporating a polymer binder having carboxyl groups, a photopolymerizable compd. having a polymerizable ethylenically unsatd. bond in each molecule and epoxy modified self-crosslinkable acrylic resin.

CONSTITUTION: This photosensitive resin compsn. contains a polymer binder (A) having carboxyl grdups, a photopolymerizable compd. (B) having at least one polymerizable ethylenically unsatd. bond in each molecule and epoxy modified self-crosslinkable acrylic resin (C). A layer of this compsn. is laminated on a substrate film. The component(A) is, e.g. a copolymer of alkyl (meth) acrylate and (meth)acrylic acid with a vinyl monomer copolymerizable with them. The component(B) is, e.g. a compd. obtd. by adding α , β – unsaid. carboxylic acid to a compd. obtd. by allowing polyol such as polypropylene glycol di (meth) acrylate to react with α , β –unsatd. carboxylic acid.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-219221

(43)公開日 平成7年(1995)8月18日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所			
G03F	7/027	502						
		503						
		515						
	7/004	512						
			7352-4M	H01L	21/30 502 R			
			審查請求	未請求 請求項	項の数3 OL (全 5 頁) 最終頁に続く			
(21)出願番号		特願平6-14298		(71)出願人	000004455			
					日立化成工業株式会社			
(22)出顧日		平成6年(1994)2	月8日		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号			
				(72)発明者	古林 寛巳			
					茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化			
					成工業株式会社山崎工場内			
				(72)発明者	川口 卓			
					茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化			
					成工業株式会社山崎工場内			
				(72)発明者	木村 仁子			
					茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化			
					成工業株式会社山崎工場内			
				(74)代理人	弁理士 若林 邦彦			

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性フィルム

(57)【要約】

【目的】 下地金属特にリードフレーム基材への密着 性、耐エッチング性、耐薬品性等に優れた感光性樹脂組 成物及び感光性フィルムを提供する。

【構成】 (A) カルボキシル基含有バインダボリマ 一、(B)分子内に少なくとも一つの重合可能なエチレ ン性不飽和結合を有する光重合性化合物及び(C)エボ キシ変性自己架橋型アクリル樹脂を含有してなる感光性 樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)カルボキシル基含有バインダボリ マー、(B)分子内に少なくとも一つの重合可能なエチ レン性不飽和結合を有する光重合性化合物及び(C)エ米

$$CH_{2} = C - C - O + CH_{2} - CH - O + C = C$$

(一般式(I)中、R'及びR'は互いに独立して水素原 子又はメチル基を表し、nは2~14の整数を表す)で 10 示される化合物を含有する請求項1記載の感光性樹脂組

【請求項3】 支持フィルム上に請求項1記戴の感光性 樹脂組成物の層を積層してなる感光性フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、【Cチップ搭載用リー ドフレーム(以下リードフレームと略す)製造に好適で 優れた特性を有する感光性樹脂組成物及びこれを用いた 感光性フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】リードフレームの製造方法にはスタンピ ング(金型打ち抜き)による方法と、感光性液状レジス ト又は感光性フィルムを用い、写真法にて像を形成した 後、エッチングにより加工するエッチング法がある。ス タンピング法は金型代が高いため多品種少量対応ができ にくく、また、ICチップの高密度化に伴なう多ピン化 対応(細細、狭小ピッチ)ができない等の問題がある。 一方、光重合性液状レシスト及び感光性フィルムを用い るエッチング法では、金型が不用になり、多品種少量生 産が可能となり、また多ピン化対応ができる利点があ り、注目されつつある。

【0003】エッチングレジストとして従来の感光性液 状レジスト (PVA、ガゼイン等の水溶性高分子)を用 いる方法は塗工に手間がかかる、塗工用設備投資が大き い、レジスト硬化にCr**を用いるため工程中に発生す る廃液管理が必要となる、現像工程後に後加熱(80~ 120℃、10~60分)を必要とする等工程が煩雑で ある。また、従来の感光性フィルムはアクリルポリマ及 びモノマを用いたものなので、下地金属が銅の場合、密 40 着性は良好であるが、下地金属が42アロイ (Fe/N i = 58/42) の場合、密着性が悪くエッチング時に もぐりが生じ易いと言う問題がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記した従 来の技術の問題を解決し、下地金属(特に42アロイ) への密着性、耐エッチング性、耐薬品性等に優れた感光 性樹脂組成物及びこれを用いた感光性フィルムを提供す るものである。

[0005]

* ポキシ変性自己架橋型アクリル樹脂を含有してなる感光 性樹脂組成物。

【請求項2】 (B) 光重合性化合物が一般式(I) 【化1】

$$\begin{array}{c}
R^{2} \\
C - C = C H_{2}
\end{array} (1)$$

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)カルボ キシル基含有バインダボリマー、(B) 分子内に少なく とも一つの重合可能なエチレン性不飽和結合を有する光 重合性化合物及び(C)エボキシ変性自己架橋型アクリ ル樹脂を含有してなる感光性樹脂組成物並びに支持体フ ィルム上にとの感光性樹脂組成物の層を積層してなる感 光性フィルムに関する。

【0006】次に本発明の感光性樹脂組成物に含まれる 成分について詳述する。本発明に(A)成分として用い られるカルボキシル基含有バインダボリマーとしては、 例えば、(メタ) アクリル酸アルキルエステル ((メ タ) アクリル酸とはメタクリル酸及びアクリル酸を意味 する。以下同じ〕と(メタ)アクリル酸とこれらと共重 合しうるビニルモノマーとの共重合体等が挙げられる。

これらの共重合体は、単独で又は2種以上を組み合わせ て用いられる。

【0007】(メタ) アクリル酸アルキルエステルとし ては、例えば、(メタ)アクリル酸メチルエステル。 (メタ) アクリル酸エチルエステル、(メタ) アクリル 酸ブチルエステル、(メタ) アクリル酸2-エチルヘキ シルエステル等が挙げられる。また、(メタ)アクリル 酸アルキルエステルや (メタ) アクリル酸と共重合しろ るビニルモノマーとしては、例えば、(メタ)アクリル 酸テトラヒドロフルフリルエステル、(メタ)アクリル 酸ジメチルアミノエチルエステル、(メタ)アクリル酸 シエチルアミノエチルエステル、メタクリル酸グリシジ ルエステル、2,2,2-トリフルオロエチル (メタ) アクリレート、2、2、3、3-テトラフルオロプロピ ル (メタ) アクリレートアクリルアミド、ジアセトンア クリルアミド、スチレン、ビニルトルエン等が挙げられ

【0008】本発明に(B)成分として用いられる分子 内に少なくとも一つの重合可能なエチレン性不飽和結合 を有する光重合性化合物としては、例えば、ポリプロビ レングリコールジ (メタ) アクリレート (プロピレン基 の数が2~14のもの)、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート (エチレン基の数が2~14のも の)、トリメチロールプロバンジ(メタ)アクリレー ト、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレー ト、テトラメチロールメタントリ (メタ) アクリレー ト、テトラメチロールメタンテトラ(メタ)アクリレー 50 ト、ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート

(プロビレン基の数が2~14のもの)、ジベンタエリスリトールベンタ(メタ)アクリレート、ジベンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート等の多価アルコールにα、β-不飽和カルボン酸を反応させて得られる化合物、ビスフェノールAジオキシエチレンジ(メタ)アクリレート、ビスフェノールAトリオキシエチレンジ(メタ)アクリレート、ビスフェノールAデカオキシエチレンジ(メタ)アクリレート等のビスフェノールAジオキシエチレンジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロバントリグリシジルエーテルトリアクリレート、ビスフェノールAジグリシジルエーテルアクリレート等米

(一般式(I)中、R¹及びR¹は互いに独立して水素原子又はメチル基を表し、nは2~14の整数を表す)で示される化合物を含有することが42アロイへの密着性の点から好ましい。一般式(I)で示される化合物としては、例えば、APG-200(n=4、新中村化学工業(株)製)、APG-400(n=7、新中村化学工業(株)製)、APG-700(n=14、新中村化学工業(株)製)等が挙げられる。これらの一般式(I)で示される化合物の使用量は、(B)光重合性化合物100重量部に対して20~50重量部であることが好ましい。20重量部未満であると42アロイへの密着性向上効果が小さい傾向があり、50重量部を越えても特に利点はない。

【0010】本発明に(C)成分として用いられるエポキシ変性自己架橋型アクリル樹脂として用いられるもの 30は、例えば、ヒタロイド2632E(日立化成工業(株)製)、ヒタロイド2672D(日立化成工業(株)製)、ヒタロイド7800J-21(日立化成工業(株)製)等が挙げられ、ヒタロイド2632Eが好ましい。

【0012】また、成分(C)の配合量は、成分(A)及び成分(B)の総和100重量部に対し、0.1~5重量部の範囲とすることが好ましい。この配合量が0.1重量部未満では効果がなく、5重量部を越えると現像残りによる不良及び安定性が極めて悪くなる等の不具合が起こりやすくなる傾向にある。

[0013] 本発明の感光性樹脂組成物は、必要に応じて可塑剤、染料、顔料、イメージング剤、充填剤、密着性付与剤等を配合して使用することができる。

*のグリシジル基含有化合物にα、β-不飽和カルボン酸を付加して得られる化合物、無水フタル酸等の多価カルボン酸とβ-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート等の水酸基及びエチレン性不飽和基を有する物質とのエステル化物、(メタ)アクリル酸メチルエステル、(メタ)アクリル酸エチルエステル、(メタ)アクリル酸ブチルエステル、(メタ)アクリル酸2-エチルへキシルエステル等の(メタ)アクリル酸のアルキルエステル、ウレタン(メタ)アクリレートなどが挙げられる。【0009】(B)光重合性化合物が一般式(1)

【0009】(B) 光重合性化合物が一般式(I) 【化2】

$$\begin{array}{c|c}
R^z \\
C - C = CH_z
\end{array}$$
 (I)

【0014】本発明の感光性樹脂組成物は、金属面、例えば、銅、ニッケル、クロム等の表面、好ましくは銅及び42アロイ表面上に、感光性フィルムとして用いられる。感光性フィルム中の感光性樹脂組成物層の厚みは用途により異なるが、乾燥後の厚みで1~100μm程度であることが好ましい。液状レジストの場合は、保護フィルムとしてポリエチレン、ポリプロビレン等の不活性なポリオレフィンフィルムなどが用いられる。

【0015】感光性フィルムは、ボリエステル等の支持体フィルム上に感光性樹脂組成物を塗布乾燥するととにより積層し、必要に応じてボリオレフィン等の保護フィルムを積層して得られる。感光性樹脂組成物は、必要に応じてアセトン、メチルエチルケトン、塩化メチレン、トルエン、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、メチルグリコール、エチルグリコール、プロピレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル等の溶剤又はこれらの混合溶剤と混合して溶液として塗布してもよい。

【0016】前記の感光性樹脂組成物層は、アートワークと呼ばれるネガ又はボジマスクバターンを通して活性光線が照射された後、現像液で現像され、レジストバターンとされる。この際用いられる活性光線としては、例えば、カーボンアーク灯、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、キセノンランプ等の紫外線を有効に放射するものが用いられる。

【0017】現像液としては、安全かつ安定であり、操作性が良好なものが用いられ、アルカリ現像型のフォト、レジストでは炭酸ナトリウムの希薄溶液等が用いられる。現像の方法には、ディップ方式、スプレー方式等があり、高圧スプレー方式が解像度向上のためには最も適している。

【0018】現像後に行われるエッチングには塩化第二 銅溶液、塩化第二鉄溶液、アルカリエッチング液及び過 酸化水素 - 硫酸素エッチング液等を用いることができる 50 が、エッチファクターが良好な点から塩化第二鉄溶液が

好ましい。

[0019]

【実施例】次に、本発明を実施例により詳しく説明する が、本発明はこれらにより制限されるものではない。

【0020】実施例1~3及び比較例1~3

メタクリル酸/メタクリル酸メチル/アクリル酸エチル 共重合体(重量比25/45/30、重量平均分子量2 5万) の25重量%メチルセロソルブ/トルエン(重量 比8/2)溶液220g(固形分55g)((A)成 分)、1, 7-ピス(9-アクリジニル)へプタン0.5g、N, N'ーテトラエチルー4, 4'ージアミノベ ンゾフェノン0.1g、シリコン系レベリング剤(SH -193、トーレシリコン(株))0.04g、マラカ イトグリーン0.1g、トリプロモメチルフェニルスル フォン1.0g、ロイコクリスタルパイオレット1.0 g、アセトン10g、トルエン10g及びメタノール3 gを配合し溶液を得た。

【0021】 この溶液に表1に示す(B) 成分及び (C) 成分を溶解させて感光性樹脂組成物の溶液を得 た。次いで、との感光性樹脂組成物の溶液を25μm厚 20 のポリエチレンテレフタレートフィルム上に均一に塗布 し、100℃の熱風対流式乾燥機で約10分間乾燥して 感光性フィルムを得た。感光性樹脂組成物層の乾燥後の 膜厚は、15μmであった。0.25mm厚42アロイ基 材上に前記感光性樹脂組成物層を120°Cに加熱しなが*

* らラミネートした。

【0022】次いで、ポリエチレンテレフタレートフィ ルム上に、ネガフィルムを載置し、3kW高圧水銀灯(オ ーク製作所社製、HMW-590)で30mJ/cmlの路光 を行った。この際、光感度を評価できるように、ネガフ ィルムに光透過量が段階的に少なくなる領域(光学密度 0.05を1段目とし、1段ごとに光学密度が0.15 ずつ増加するステップタブレット)を設けた。

6

【0023】次いで、ポリエチレンテレフタレートフィ 10 ルムを除去し、30℃で1重量%炭酸ナトリウム水溶液 を30秒間スプレーするととにより、未露光部分を除去 し、その際、現像残りを目視観察した。さらに、42ア ロイ基材上に形成された光硬化膜のステップタブレット の段数を測定することにより、感光性樹脂組成物の光感 度を評価した。その結果を表1に示す。光感度は、ステ ップタブレットの段数で示され、とのステップタブレッ トの段数が高いほど、光感度が高いことを示す。

【0024】次いで現像処理したものを、塩化第二鉄溶 液60℃240秒エッチングを行い、次いで3重量%N aOH、50℃のシャワーを行い、レジストはくりし、 エッチングもぐりの程度を観察した。結果を表1に示

[0025]

【表1】

表 .

	<u> </u>	実施例1	実施例 2	実施例3	比較例 1	比較例 2	比較例3
成分(B)	BPE-1*1	3 5	3 5	2.5	3 5	3 5	2 5
	MECHPP *2	10	10	1 0	10	10	10
	APG-400 *3	- .		10	_	. –	10
戌分(C)	ヒタロイド2632E *4	1	5	1	_	10	-
評価項目	エッチングもぐり *5	0	6	8	×	0	Δ
	現 像 の こ り*6	0	. 0	0	0	×	0
	贈 皮	8.0	.7.5	8.0	8.5	7.0	8. 5

(注)成分(B)及び成分(C)の数値は固型分のg数を示す。

*1: ピスフェノールAポリオキシエチレンジメタクリレート (新中村工業社製商品名)

*2: γ - ρ - μ - μ - μ - μ + μ +阪有機化学工業(株))

*3:ポリプロピレングリコールジアクリレート(新中村化学(株))

*4:エポキシ変性自己架機型アクリル樹脂(日立化成工業(株))

*5:評価基準 ②:エッチングもぐりなし Δ: 5~20μのエッチングもぐりあり

〇:5 #未満のエッチングもぐりあり ×:20 µ以上のエッチングもぐりあり

*6: 評価基準 〇:現像残りなし ×:現像残りあり

【0026】表1から明らかなように、エポキシ変性自 己架橋型アクリル樹脂を用いることにより、エッチング もぐりが改善され、更に、ポリプロピレングリコールジ 50

アクリレートを用いることでエッチングもぐりが改良さ れることが分かる。

[0027]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物及びこれを用 *ング性、耐薬品性等に優れたものである。いた感光性フィルムは、下地金属への密着性、耐エッチ*

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G03F 7/033 H01L 21/027